技术创新需求调查表

|  |
| --- |
| **企业信息** |
| 企业名称 | 第三届中国创新挑战赛（上海）组委会 | 机构代码 |  |
| 区 域 |  | 联系人 | 唐旭东 | 电话 | 13917662089 |
| 行业领域 |  | 产业领域 |  |
| 经济规模 |  | 人员规模 |  |
| **需求信息** |
| 技术需求情况说明 | 技术需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术）■产品研发（产品升级、新产品研发）□技术改造（设备、研发生产条件）□技术配套（技术、产品等配套合作） |
| 技术需求简述 | 公司研发生产测试探针，半导体测试探针，射频测试探针，射频模块，连接器等产品。在产品研发过程中，对产品的电镀技术提出新的要求，寻求专家解决。 |
|  | 技术需求详述 | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标）公司研发生产测试探针，半导体测试探针，射频测试探针，射频模块，连接器等产品。在产品研发过程中，对产品的电镀技术提出新的要求，寻求专家解决。电镀技术要求： 1.超精密电镀技术，0.15mm内径通孔电镀。 2.高碳钢材料电镀技术，要求表面光滑。 3.类颜色处理的更为光亮，以及材料表面的光洁度处理。 |
| 现有基础情况 | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等）迫切性：长期有效完成时间:无预算金额：面谈 |
| 产学研合作需求 | 需求描述 | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） |
| 合作方式 | □技术转让 □技术入股 ■联合开发 ■委托研发 ■委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 ■其他 无  |
| **管理信息** |
| 同意公开需求信息 |  ■是 □否 □部分公开(说明）  |
| 同意接受专家服务 |  ■是  □否 |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 |  ■是 □否 |
| 同意对优秀解决方案给予奖励 |  □是，金额 万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件） ■否 法人代表： 年 月 日 |